

合肥晶合集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕954号）。《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>；经济参考网，<http://www.jjckb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	合肥晶合集成电路股份有限公司	证券简称	晶合集成
证券代码/网下申购代码	688249	网上申购代码	787249

网下申购简称	晶合集成	网上申购简称	晶合申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式		
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	150,460.1368	拟发行数量（万股） （超额配售选择权行使前）	50,153.3789
预计新股发行数量（万股） （超额配售选择权行使前）	50,153.3789	预计老股转让数量（万股）	0.0000
发行后总股本（万股） （超额配售选择权行使前）	200,613.5157	拟发行数量占发行后总股本的比例（%） （超额配售选择权行使前）	25.00
是否有超额配售选择权安排	是	超额配售选择权股份数量（万股）	7,523.0000
发行后总股本（万股） （超额配售选择权全额行使后）	208,136.5157	拟发行数量占发行后总股本的比例（%） （超额配售选择权全额行使后）	27.71
网上初始发行数量（万股）	7,021.4500	网下初始发行数量（万股）	28,085.9153
网下每笔拟申购数量上限（万股）	6,000	网下每笔拟申购数量下限（万股）	150
初始战略配售数量（万股）	15,046.0136	初始战略配售占拟发行数量比（%）	30.00
保荐人相关子公司 初始跟投股数（万股）	1,003.0676	高管核心员工专项资管计划认购股数/ 金额上限（万股/万元）	5,015.3378 万股/不超过 40,292.8926 万元
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023 年 4 月 17 日 09:30 - 15:00	发行公告刊登日	2023 年 4 月 19 日
网下申购日及起止时间	2023 年 4 月 20 日 09:30 - 15:00	网上申购日及起止时间	2023 年 4 月 20 日 09:30 - 11:30

			13:00 - 15:00
网下缴款日及截止时间	2023 年 4 月 24 日 16:00	网上缴款日及截止时间	2023 年 4 月 24 日日 终
备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 576,763,789 股			
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	合肥晶合集成电路股份有限公司		
联系人	朱才伟	联系电话	0551-62637000
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620567

发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司
 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
 2023 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）



发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司

2023年4月12日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

